# 2023-2028年中国高端芯片行业市场调查研究及发 展战略规划报告

报告大纲

华经情报网 www.huaon.com

## 一、报告简介

华经情报网发布的《2023-2028年中国高端芯片行业市场调查研究及发展战略规划报告》涵盖行业最新数据,市场热点,政策规划,竞争情报,市场前景预测,投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址: https://www.huaon.com//channel/ic/852897.html

报告价格: 电子版: 9000元 纸介版: 9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明:本PDF目录为计算机程序生成,格式美观性可能有欠缺;实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

#### 报告目录:

第一章 高端芯片行业相关概述

- 1.1芯片相关介绍
- 1.1.1基本概念
- 1.1.2摩尔定律
- 1.1.3芯片分类
- 1.1.4产业链条
- 1.1.5商业模式
- 1.2高端芯片相关概述
- 1.2.1高端概念界定
- 1.2.2高级逻辑芯片
- 1.2.3高级存储芯片
- 1.2.4高级模拟芯片
- 1.2.5芯片进程发展

第二章 2018-2022年国际高端芯片行业发展综合分析

- 2.1 2018-2022年全球芯片行业发展情况分析
- 2.1.1全球经济形势分析
- 2.1.2全球芯片销售规模
- 2.1.3全球芯片区域市场
- 2.1.4全球芯片产业分布
- 2.1.5全球芯片细分市场
- 2.1.6全球芯片需求现状
- 2.1.7全球芯片重点企业
- 2.2 2018-2022年全球高端芯片行业现况分析
- 2.2.1高端芯片市场现状
- 2.2.2高端逻辑芯片市场
- 2.2.3高端存储芯片市场
- 2.3 2018-2022年美国高端芯片行业发展分析
- 2.4 2018-2022年韩国高端芯片行业发展分析

- 2.5 2018-2022年日本高端芯片行业发展分析
- 2.6 2018-2022年中国台湾高端芯片行业发展分析
- 2.6.1中国台湾芯片发展现状
- 2.6.2中国台湾芯片市场规模
- 2.6.3中国台湾芯片产业链布局
- 2.6.4台湾与大陆产业优势互补
- 2.6.5美国对台湾芯片发展影响

第三章 2018-2022年中国高端芯片行业发展环境分析

- 3.1政策环境
- 3.1.1智能制造行业政策
- 3.1.2行业监管主体部门
- 3.1.3行业相关政策汇总
- 3.1.4集成电路税收政策
- 3.2经济环境
- 3.2.1宏观经济概况
- 3.2.2对外经济分析
- 3.2.3工业经济运行
- 3.2.4固定资产投资
- 3.2.5宏观经济展望
- 3.2.6中美科技战影响
- 3.3投融资环境
- 3.3.1美方制裁加速投资
- 3.3.2社会资本推动作用
- 3.3.3大基金投融资情况
- 3.3.4地方政府产业布局
- 3.3.5设备资本市场情况
- 3.4人才环境
- 3.4.1需求现状概况
- 3.4.2人才供需失衡
- 3.4.3创新人才紧缺
- 3.4.4培养机制不健全

第四章 2018-2022年中国高端芯片行业综合分析

- 4.1 2018-2022年中国芯片行业发展业态
- 4.1.1芯片市场发展规模
- 4.1.2芯片细分产品业态

- 4.1.3芯片设计行业发展
- 4.1.4芯片制造行业发展
- 4.1.5芯片封测行业发展
- 4.2 2018-2022年中国高端芯片发展情况
- 4.2.1高端芯片行业发展现状
- 4.2.2高端芯片细分产品发展
- 4.2.3高端芯片技术发展方向
- 4.3中国高端芯片行业发展问题
- 4.3.1芯片产业核心技术问题
- 4.3.2芯片产业生态构建问题
- 4.3.3高端芯片资金投入问题
- 4.3.4国产高端芯片制造问题
- 4.4中国高端芯片行业发展建议
- 4.4.1尊重市场发展规律
- 4.4.2上下环节全面发展
- 4.4.3加强全球资源整合

第五章 2018-2022年高性能CPU行业发展分析

- 5.1 CPU相关概述
- 5.1.1 CPU基本介绍
- 5.1.2 CPU主要分类
- 5.1.3 CPU的指令集
- 5.1.4 CPU的微架构
- 5.2高性能CPU技术演变
- 5.2.1 CPU总体发展概述
- 5.2.2指令集更新与优化
- 5.2.3微架构的升级过程
- 5.3 CPU市场发展情况分析
- 5.3.1产业链条结构分析
- 5.3.2全球高端CPU供需分析
- 5.3.3国产高端CPU发展现状
- 5.3.4国产高端CPU市场前景
- 5.4 CPU细分市场发展分析
- 5.4.1服务器CPU市场
- 5.4.2 PC领域CPU市场
- 5.4.3移动计算CPU市场

- 5.5 CPU行业代表企业CPU产品业务分析
- 5.5.1 AMDCPU产品分析
- 5.5.2英特尔CPU产品分析
- 5.5.3苹果CPU产品分析

第六章 2018-2022年高性能GPU行业发展分析

- 6.1 GPU基本介绍
- 6.1.1 GPU概念阐述
- 6.1.2 GPU的微架构
- 6.1.3 GPU的API介绍
- 6.1.4 GPU显存介绍
- 6.1.5 GPU主要分类
- 6.2高性能GPU演变分析
- 6.2.1 GPU技术发展历程
- 6.2.2 GPU微架构进化过程
- 6.2.3先进制造升级历程
- 6.2.4主流高端GPU发展
- 6.3高性能GPU市场分析
- 6.3.1 GPU产业链条分析
- 6.3.2全球GPU发展现状
- 6.3.3全球供需情况概述
- 6.3.4国产GPU发展情况
- 6.3.5国内GPU企业布局
- 6.3.6国内高端GPU研发
- 6.4 GPU细分市场分析
- 6.4.1服务器GPU市场
- 6.4.2移动电子GPU市场
- 6.4.3 PC领域GPU市场
- 6.4.4 AI领域GPU芯片市场
- 6.5高性能GPU行业代表企业产品分析
- 6.5.1英伟达GPU产品分析
- 6.5.2 AMDGPU产品分析
- 6.5.3英特尔GPU产品分析

第七章 2018-2022年FPGA芯片行业发展综述

- 7.1 FPGA芯片概况综述
- 7.1.1定义及物理结构

- 7.1.2芯片特点与分类
- 7.1.3不同芯片的区别
- 7.1.4 FPGA技术分析
- 7.2 FPGA芯片行业产业链分析
- 7.2.1 FPGA市场上游分析
- 7.2.2 FPGA市场中游分析
- 7.2.3 FPGA市场下游分析
- 7.3全球FPGA芯片市场发展分析
- 7.3.1 FPAG市场发展现状
- 7.3.2 FPGA全球竞争情况
- 7.3.3 AI领域FPGA的发展
- 7.3.4 FPGA芯片发展趋势
- 7.4中国FPGA芯片市场发展分析
- 7.4.1中国FPGA市场规模
- 7.4.2中国FPGA竞争格局
- 7.4.3中国FPGA企业现状
- 第八章 2018-2022年存储芯片行业发展分析
- 8.1存储芯片发展概述
- 8.1.1存储芯片定义及分类
- 8.1.2存储芯片产业链构成
- 8.1.3存储芯片技术发展
- 8.2存储芯片市场发展情况分析
- 8.2.1存储芯片行业驱动因素
- 8.2.2全球存储芯片发展规模
- 8.2.3中国存储芯片销售规模
- 8.2.4国产存储芯片发展现状
- 8.2.5存储芯片行业发展趋势
- 8.3高端DRAM芯片市场分析
- 8.3.1高端DRAM概念界定
- 8.3.2 DRAM芯片产品分类
- 8.3.3 DRAM芯片应用领域
- 8.3.4 DRAM芯片市场现状
- 8.3.5 DRAM市场需求态势
- 8.3.6企业高端DRAM布局
- 8.3.7高端DRAM工艺发展

- 8.3.8国产DRAM研发动态
- 8.3.9 DRAM技术发展潜力
- 8.4高性能NAND Flash市场分析
- 8.4.1 NANDFlash概念
- 8.4.2 NANDFlash技术路线
- 8.4.3 NANDFlash市场发展规模
- 8.4.4 NANDFlash市场竞争情况
- 8.4.5 NANDFlash需求业态分析
- 8.4.6高端NAND Flash研发热点
- 8.4.7国内NAND Flash代表企业

第九章 2018-2022年人工智能芯片行业发展分析

- 9.1人工智能芯片概述
- 9.1.1人工智能芯片分类
- 9.1.2人工智能芯片主要类型
- 9.1.3人工智能芯片对比分析
- 9.1.4人工智能芯片产业链
- 9.2人工智能芯片行业发展情况
- 9.2.1全球AI芯片市场规模
- 9.2.2国内AI芯片发展现状
- 9.2.3国内AI芯片主要应用
- 9.2.4国产AI芯片厂商分布
- 9.2.5国内主要AI芯片厂商
- 9.3人工智能芯片在汽车行业应用分析
- 9.3.1 AI芯片智能汽车应用
- 9.3.2车规级芯片标准概述
- 9.3.3汽车AI芯片市场格局
- 9.3.4汽车AI芯片国外龙头企业
- 9.3.5汽车AI芯片国内龙头企业
- 9.3.6智能座舱芯片发展
- 9.3.7自动驾驶芯片发展
- 9.4云端人工智能芯片发展解析
- 9.4.1云端AI芯片市场需求
- 9.4.2云端AI芯片主要企业
- 9.4.3互联网企业布局分析
- 9.4.4云端AI芯片发展动态

- 9.5边缘人工智能芯片发展情况
- 9.5.1边缘AI使用场景
- 9.5.2边缘AI芯片市场需求
- 9.5.3边缘AI芯片市场现状
- 9.5.4边缘AI芯片主要企业
- 9.5.5边缘AI芯片市场前景
- 9.6人工智能芯片行业未来发展趋势
- 9.6.1 AI芯片未来技术趋势
- 9.6.2边缘智能芯片市场机遇
- 9.6.3终端智能计算能力预测
- 9.6.4智能芯片一体化生态发展
- 第十章 2018-2022年5G芯片行业发展分析
- 10.1 5G芯片行业发展分析
- 10.1.1 5G芯片分类
- 10.1.2 5G芯片产业链
- 10.1.3 5G芯片发展历程
- 10.1.4 5G芯片市场需求
- 10.1.5 5G芯片行业现状
- 10.1.6 5G芯片市场竞争
- 10.1.7 5G芯片企业布局
- 10.2 5G基带芯片市场发展情况
- 10.2.1基带芯片基本定义
- 10.2.2基带芯片组成部分
- 10.2.3基带芯片基本架构
- 10.2.4基带芯片市场现状
- 10.2.5基带芯片竞争现状
- 10.2.6国产基带芯片发展
- 10.3 5G射频芯片市场发展情况
- 10.3.1射频芯片基本介绍
- 10.3.2射频芯片组成部分
- 10.3.3射频芯片发展现状
- 10.3.4射频芯片企业布局
- 10.3.5射频芯片研发动态
- 10.3.6射频芯片技术壁垒
- 10.3.7射频芯片市场空间

- 10.4 5G物联网芯片市场发展情况
- 10.4.1物联网芯片重要地位
- 10.4.2 5G时代物联网通信
- 10.4.3 5G物联网芯片布局
- 10.5 5G芯片产业未来发展前景分析
- 10.5.1 5G行业趋势分析
- 10.5.2 5G芯片市场趋势
- 10.5.3 5G芯片应用前景
- 第十一章 2018-2022年光通信芯片行业发展分析
- 11.1光通信芯片相关概述
- 11.1.1光通信芯片介绍
- 11.1.2光通信芯片分类
- 11.1.3光通信芯片产业链
- 11.2光通信芯片产业发展情况
- 11.2.1光通信芯片产业发展现状
- 11.2.2光通信芯片技术发展态势
- 11.2.3光通信芯片产业主要企业
- 11.2.4高端光通信芯片竞争格局
- 11.2.5高端光通信芯片研发动态
- 11.3光通信芯片行业投融资潜力分析
- 11.3.1行业投融资情况
- 11.3.2行业项目投资案例
- 11.3.3行业项目投资动态
- 11.4光通信芯片行业发展趋势
- 11.4.1国产替代规划
- 11.4.2行业发展机遇
- 11.4.3行业发展趋势
- 11.4.4产品发展趋势
- 第十二章 2018-2022年其他高端芯片市场发展分析
- 12.1高精度ADC芯片市场分析
- 12.1.1 ADC芯片概述
- 12.1.2 ADC芯片技术分析
- 12.1.3 ADC芯片设计架构
- 12.1.4 ADC芯片市场需求
- 12.1.5 ADC芯片主要市场

- 12.1.6高端ADC芯片市场格局
- 12.1.7国产高端ADC芯片发展
- 12.1.8高端ADC芯片进入壁垒
- 12.2高端MCU芯片市场分析
- 12.2.1 MCU芯片发展概况
- 12.2.2 MCU芯片市场规模
- 12.2.3 MCU芯片竞争格局
- 12.2.4国产高端MCU芯片发展
- 12.2.5智能MCU芯片发展分析
- 12.3 ASIC芯片市场运行情况
- 12.3.1 ASIC芯片定义及分类
- 12.3.2 ASIC芯片应用领域
- 12.3.3 ASIC芯片技术升级现状
- 12.3.4人工智能ASIC芯片应用
- 第十三章 2018-2022年国际高端芯片行业主要企业运营情况
- 13.1高通
- 13.2三星
- 13.3英特尔
- 13.4英伟达
- 13.5 AMD
- 13.6联发科
- 第十四章 2018-2022年国内高端芯片行业主要企业运营情况
- 14.1海思半导体
- 14.1.1企业发展概况
- 14.1.2产品发展分析
- 14.1.3服务领域分析
- 14.1.4企业营收情况
- 14.2紫光展锐
- 14.2.1企业发展概况
- 14.2.2企业主要产品
- 14.2.3 5G芯片业务发展
- 14.2.4手机芯片技术动态
- 14.3光迅科技
- 14.3.1企业发展概况
- 14.3.2经营效益分析

- 14.3.3业务经营分析
- 14.3.4财务状况分析
- 14.3.5核心竞争力分析
- 14.3.6公司发展战略
- 14.3.7未来前景展望
- 14.4寒武纪科技
- 14.4.1企业发展概况
- 14.4.2经营效益分析
- 14.4.3业务经营分析
- 14.4.4财务状况分析
- 14.4.5核心竞争力分析
- 14.4.6公司发展战略
- 14.4.7未来前景展望
- 14.5盛景微电子
- 14.5.1企业发展概况
- 14.5.2经营效益分析
- 14.5.3业务经营分析
- 14.5.4财务状况分析
- 14.5.5核心竞争力分析
- 14.5.6公司发展战略
- 14.5.7未来前景展望
- 14.6兆易创新
- 14.6.1企业发展概况
- 14.6.2经营效益分析
- 14.6.3业务经营分析
- 14.6.4财务状况分析
- 14.6.5核心竞争力分析
- 14.6.6公司发展战略
- 14.6.7未来前景展望
- 第十五章 2023-2028年高端芯片行业投融资分析及发展前景预测
- 15.1中国高端芯片行业投融资环境
- 15.1.1美方制裁加速投资
- 15.1.2社会资本推动作用
- 15.1.3大基金投融资情况
- 15.1.4地方政府产业布局

- 15.1.5设备资本市场情况
- 15.2中国高端芯片行业投融资分析
- 15.2.1高端芯片行业投融资态势
- 15.2.2高端芯片行业投融资动态
- 15.2.3高端芯片行业投融资趋势
- 15.2.4高端芯片行业投融资壁垒
- 15.3国际高端芯片行业未来发展趋势
- 15.3.1全球高端芯片行业技术趋势
- 15.3.2中国高端芯片行业增长趋势
- 15.3.3中国高端芯片行业发展前景
- 15.4中国高端芯片行业应用市场展望
- 15.4.1 5G手机市场需求强劲
- 15.4.2服务器市场保持涨势
- 15.4.3 PC电脑市场需求旺盛
- 15.4.4智能汽车市场稳步发展
- 15.4.5智能家居市场快速发展

#### 图表目录:

- 图表2022导体销售规模地域分布
- 图表中国存储器芯片行业技术发展分析
- 图表传统内存处理与物联网内存处理方案对比
- 图表2023-2028年全球存储芯片市场规模及预测
- 图表2018-2022年中国存储器芯片行业市场规模
- 图表2023-2028年DRAM需求供给情况及预测
- 图表2018-2022年全球NAND市场规模
- 图表2018-2022年各NAND厂商占比情况
- 更多图表见正文......

详细请访问: https://www.huaon.com//channel/ic/852897.html